

本期封面

2006年2

栏目：2

DOI:

论文题目： In-Sn合金熔体在非晶和晶态Cu<sub>46</sub>Zr<sub>45</sub>Al<sub>7</sub>Gd<sub>2</sub>合金上的润湿性及界面特性

作者姓名： 马广才, 李文, 李宏, 张海峰, 胡壮麒

工作单位： 中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室; 沈阳理工大学材料科学与工程学院

通信作者： 李文

通信作者Email: [wenli@imr.ac.cn](mailto:wenli@imr.ac.cn)

文章摘要： 用座滴法研究了In-Sn合金熔体在非晶和晶态Cu<sub>46</sub>Zr<sub>45</sub>Al<sub>7</sub>Gd<sub>2</sub>合金上的润湿性, 利用扫描电镜(SEM)、电子探针(EPMA)、X射线衍射(XRD)分析了In-Sn/Cu<sub>46</sub>Zr<sub>45</sub>Al<sub>7</sub>Gd<sub>2</sub>界面特性. 结果表明: In-Sn合金熔体在非晶合金上的润湿性优于在晶态合金上的润湿性; In-Sn合金熔体在非晶基片上的反应扩散层宽度要小于在晶态基片上的反应扩散层宽度; In-Sn合金熔体在非晶基片上的反应扩散区中出现晶化反应.

关键词： In-Sn; Cu基合金; 非晶合金; 润湿; 界面

分类号： TG166.2

关闭